

はんだ不良を未然に防ぐための

WEB受講可
アーカイブ配信
7日間何度でも
視聴可能
(WEB受講の場合)

製造側から見たプリント基板への
要求仕様の具体的ポイント

◆日時：2025年5月21日（水）11:00～17:00

◆会場：TH企画セミナールームA ※会場/WEB 選択可
(東京・JR田町駅下車 徒歩約6分)

◆受講料：(消費税等込) 1名:49,500円
同一セミナー 同一企業同時複数人数申込の場合 1名:44,000円

◆受講資料：製本テキスト(受講料に含)
※別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円（内税）

ライブ配信/アーカイブ配信（7日間、何度でも視聴可）
※当日の出席・欠席の有無は問いません

基本的な基板の設計ルール、はんだ不良を少なくする部品配置・設備・材料条件、ノイズの発生低減のための基板の回路設計、発熱を抑制する基板回路設計、部品のメッキ・表面処理について、豊富な経験に基づき、動画を交えながら分かりやすく解説する特別セミナー！！

【講師の言葉】

はんだ付けでは、まずベースにあるのは、プリント基板です。量産になると、はんだ付けでは “はんだ不良” が常に伴います。“品質の向上” が昔から叫ばれていますが、特にプリント基板の設計によるところが大きいです。

最近では、日本よりも中国を主に、海外で生産することが多くなり、基板の設計にかかる比重が大きくなっています。ここでは、基本的な用語の説明から始まり、はんだ不良を未然に防ぐ為の方策について、基板の品質の向上について、知って頂きます。プリント基板設計は、それぞれの業界によって異なりますが、一般論として、述べています。はんだ不良を発生させない部品配置、ノイズ対策、基板の発熱対策、部品のメッキや表面処理まで範囲を広げました。全てを網羅することは困難かと思いますが、基板設計上の“気づき” に役立てば幸いです。

一部 動画を使いながら説明していきますので、イメージを掴んで、理解を深めて下さい。

【受講形式】 会場・WEB選択可

【受講対象】 はんだ付け業務に従事されている方
プリント基板設計、製造現場ではんだ不良対策で課題を抱えている方々

【予備知識】 特に必要ありません。

【習得知識】 1) 基本的な基板の設計ルール
2) はんだ不良を少なくする部品配置、設備、材料条件について
3) ノイズの発生を少なくする基板の回路設計
4) 発熱を抑制する為の基板の回路設計
5) 部品のメッキ及び表面処理について など

●申込書 ・2025年5月21日（水）「製造側から見た プリント基板への要求仕様の具体的ポイント」

会社名		〒		住所	
TEL				FAX	
正式所属				正式所属	
受講者名				受講者名	
E-mail				E-mail	
振り込み 予定				通信欄	

セミナーご案内 関連部署へご回覧願います

◆ プ ロ グ ラ ム ◆

【講師】 株式会社弘輝テック 実装シニアアドバイザー 谷口 成人 先生
元 住友電装株式会社電子事業本部 生技開発部 担当部長

1 基本的な用語の説明

2 設計ルール(推奨)

3 はんだ不良を少なくする部品配置(推奨)

・ 他、はんだ不良を少なくする設備推奨条件

・ はんだ不良を少なくする材料推奨条件

4 ノイズ対策(抜粋)

5 パレット治具を用いる場合の
基板との干渉領域(推奨)

6 基板発熱対策(推奨)

7 部品のメッキ及び表面処理について

8 その他(温度プロファイル(推奨)etc)

9 よくあるご質問について

・ 温度プロファイルで何故予熱を高く、一定に保持しないといけないのか。

・ 基板への要求仕様を多く取り上げれば、はんだ不良は少なくなるのか。



質疑・応答

【受講者の声】 ・プリント基板についての基礎的な情報、電子部品、はんだについて知識があるわけではなかったのが勉強になった。
・プリント配線基板に関する基礎については概ね理解できた。多層基板の製作方法（コア基板、めっき方法etc.）についてプロセス含め分かりやすかった。
・事例・動画が豊富でイメージしやすかった。
・映像を交えた解説で非常に理解が進みました。ありがとうございました。

◆セミナーお申込要領

●申し込み方法
・弊社ホームページの申込欄又は、FAXかE-mailにてお申し込みください。
・折り返し、受講票、請求書、会場案内図をお送り致します。
・開催日の8日前以内のキャンセルは、お受け致しますので、必要に応じ代理の方のご出席をお願いします。
・開催日の8日前以内のキャンセルの場合、受講料の全額を申し受けます。

●お支払い方法
受講料は原則として開催前日までにお支払い願います。経理上、受講料のお支払いがセミナー開催後になる場合は、お支払日をお知らせ願います。
振り込み手数料は御社の御負担にてお願いします。

●申込先  TH企画 セミナーセンター
株式会社 TH企画
〒108-0014 東京都港区芝4-5-1 1F
TEL:03-6435-1138
FAX:03-6435-3685
E-mail:th@thplan.com
検索  TH企画 → サイト内検索 0521 (開催日)

詳細、その他のセミナーは、ホームページをご覧ください。
<https://www.thplan.com/>